



2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年8月3日

上場会社名 芝浦メカトロニクス株式会社 上場取引所 東
コード番号 6590 URL <https://www.shibaura.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 今村 圭吾
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 専務執行役員経営管理本部長 (氏名) 池田 賢一 TEL 045-897-2425
四半期報告書提出予定日 2023年8月9日 配当支払開始予定日 -
四半期決算補足説明資料作成の有無：有（当社ウェブサイトには決算説明資料を掲載予定です。）
四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第1四半期の連結業績（2023年4月1日～2023年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第1四半期	14,254	3.1	2,129	0.4	2,209	15.5	1,794	7.1
2023年3月期第1四半期	13,821	36.8	2,120	222.6	1,912	214.4	1,675	-

(注) 包括利益 2024年3月期第1四半期 1,843百万円 (3.8%) 2023年3月期第1四半期 1,775百万円 (-%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第1四半期	406.02	-
2023年3月期第1四半期	379.21	-

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年3月期第1四半期	81,574	32,373	39.7	7,323.31
2023年3月期	81,887	33,007	40.3	7,466.67

(参考) 自己資本 2024年3月期第1四半期 32,373百万円 2023年3月期 33,007百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	-	0.00	-	560.00	560.00
2024年3月期	-	-	-	-	-
2024年3月期（予想）	-	0.00	-	120.00	-

(注) 1. 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：無

2. 2023年5月11日開催の取締役会において、2023年10月1日を効力発生日として、当社普通株式を1株につき3株の割合で株式分割することを決議いたしました。2024年3月期（予想）の1株当たり期末配当金については、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「-」と記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の2024年3月期（予想）の期末配当金は360円00銭、年間配当金合計は360円00銭となります。

3. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	59,000	△3.3	7,300	△33.1	6,700	△36.3	5,200	△43.5	392.10

- （注） 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無
 2. 2024年3月期（予想）における通期の1株当たり当期純利益については、「2. 配当の状況」に注記した株式分割を考慮した額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の1株当たり当期純利益は1,176円31銭となります。

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
 ② ①以外の会計方針の変更：無
 ③ 会計上の見積りの変更：無
 ④ 修正再表示：無

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年3月期1Q	4,657,300株	2023年3月期	5,192,619株
② 期末自己株式数	2024年3月期1Q	236,695株	2023年3月期	772,014株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年3月期1Q	4,420,605株	2023年3月期1Q	4,417,778株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する主旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P. 2「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(追加情報)	8
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

①業績全般について

当第1四半期連結累計期間における当社グループの事業環境は、スマートフォン、パソコンの需要低下などを受け、半導体業界においてはメモリ向けを中心に設備投資の減速が見られ、F P D (Flat Panel Display) 業界においては全般的に設備投資が低調な状況が継続しました。その一方で、半導体業界においてI o T、5 G、A Iなどの需要は引き続き底堅く、ロジック/ファウンドリ向け、パワーデバイス向け、及びウェーハ向けなどの設備投資がいずれも堅調に推移しました。また、いずれの業界においても部品や部材の供給が不安定な状況が続きました。

このような環境の中、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高は、前年同期に比べ半導体分野では増加、F P D分野では減少し、全体では14,254百万円(前年同期比3.1%増)となりました。利益面では、研究開発の強化などによる販売費及び一般管理費の増加があったものの、半導体前工程の売上増加により営業利益が2,129百万円(前年同期比0.4%増)、為替の影響もあり、経常利益が2,209百万円(前年同期比15.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益が1,794百万円(前年同期比7.1%増)となりました。

なお、受注高は、半導体分野は高水準であった前年同期に比べ減少はしたものの全体として堅調に推移しました。一方F P D分野は低調に推移しました。この結果、当第1四半期連結累計期間における受注高は17,711百万円(前年同期比38.8%減)となりました。

②セグメントの業績について

主な事業セグメントの業績は次のとおりです。

(ファインメカトロニクス部門)

売上高は、半導体前工程ではロジック/ファウンドリ向け装置及びウェーハ向け装置がいずれも順調に推移し、前年同期に比べ増加しました。一方F P D前工程は低調で、前年同期に比べ減少しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ増収となり、11,170百万円(前年同期比30.7%増)となりました。

セグメント利益は、半導体前工程での売上増加により2,146百万円(前年同期比59.1%増)となりました。

なお、受注高は、半導体前工程では全体として堅調に推移したものの、特に好調であった前年同期に比べ減少しました。F P D前工程では顧客の設備投資の影響を受け低調に推移しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ受注高が減少し、11,521百万円(前年同期比47.2%減)となりました。

(メカトロニクスシステム部門)

売上高は、半導体後工程では前年同期に比べ減少しましたが、その中でも先端パッケージ向け装置は堅調に推移しました。F P D後工程では、前年度、特に後半の受注が低調だったことを受け前年同期に比べ減少しました。真空応用装置も前年同期に比べ減少しましたが、半導体分野向けは堅調に推移しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ減収となり、2,055百万円(前年同期比51.8%減)となりました。

セグメント利益は、半導体後工程での売上減少の影響により39百万円(前年同期比94.7%減)となりました。

なお、受注高は、半導体後工程では生成A I用G P Uの需要増に伴い先端パッケージ向け装置が堅調に推移しました。F P D後工程では顧客の設備投資の影響を受け低調に推移し、前年同期に比べ大幅に減少しました。真空応用装置では、半導体分野向けを中心に順調に推移しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ受注高が減少し、5,047百万円(前年同期比16.8%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ313百万円減少し81,574百万円となりました。これは主に商品及び製品が455百万円、建設仮勘定が1,358百万円増加した一方で現金及び預金が715百万円、未収入金が1,286百万円減少したことによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ320百万円増加し49,201百万円となりました。これは主に前受金が1,245百万円増加したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ633百万円減少し32,373百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年5月11日に公表いたしました通期連結業績予想から変更ありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,175	26,459
受取手形、売掛金及び契約資産	31,844	31,326
電子記録債権	799	898
商品及び製品	1,376	1,832
仕掛品	4,935	5,108
原材料及び貯蔵品	200	277
未収入金	2,203	917
その他	315	503
貸倒引当金	△1,440	△1,438
流動資産合計	67,409	65,885
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	28,572	28,800
減価償却累計額	△20,489	△20,601
建物及び構築物(純額)	8,082	8,198
機械装置及び運搬具	7,401	7,801
減価償却累計額	△5,308	△5,612
機械装置及び運搬具(純額)	2,092	2,188
工具、器具及び備品	1,366	1,406
減価償却累計額	△1,117	△1,146
工具、器具及び備品(純額)	248	260
土地	119	119
リース資産	96	115
減価償却累計額	△63	△67
リース資産(純額)	33	47
建設仮勘定	1,086	2,444
有形固定資産合計	11,663	13,260
無形固定資産		
特許権	388	391
その他	216	193
無形固定資産合計	604	585
投資その他の資産		
投資有価証券	0	0
長期前払費用	12	13
繰延税金資産	1,984	1,608
その他	214	222
貸倒引当金	△1	△1
投資その他の資産合計	2,211	1,843
固定資産合計	14,478	15,689
資産合計	81,887	81,574

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,518	11,432
電子記録債務	3,897	3,911
短期借入金	3,750	3,750
リース債務	16	18
未払法人税等	1,684	189
未払費用	3,926	3,336
前受金	8,099	9,345
役員賞与引当金	146	51
製品保証引当金	108	117
その他	846	2,248
流動負債合計	33,995	34,400
固定負債		
長期借入金	5,000	5,000
リース債務	20	32
退職給付に係る負債	6,380	6,277
役員退職慰労引当金	28	29
修繕引当金	310	315
資産除去債務	67	67
長期預り保証金	3,078	3,078
固定負債合計	14,885	14,800
負債合計	48,880	49,201
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,761	6,761
資本剰余金	9,037	6,939
利益剰余金	20,944	19,588
自己株式	△3,998	△1,225
株主資本合計	32,745	32,062
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	535	545
退職給付に係る調整累計額	△274	△234
その他の包括利益累計額合計	261	310
純資産合計	33,007	32,373
負債純資産合計	81,887	81,574

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
売上高	13,821	14,254
売上原価	8,660	8,627
売上総利益	5,160	5,627
販売費及び一般管理費	3,039	3,498
営業利益	2,120	2,129
営業外収益		
受取利息	0	0
受取配当金	—	0
為替差益	261	427
その他	21	17
営業外収益合計	283	445
営業外費用		
支払利息	21	17
デリバティブ評価損	447	266
その他	22	80
営業外費用合計	491	365
経常利益	1,912	2,209
税金等調整前四半期純利益	1,912	2,209
法人税、住民税及び事業税	67	38
法人税等調整額	169	375
法人税等合計	237	414
四半期純利益	1,675	1,794
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,675	1,794

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
四半期純利益	1,675	1,794
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	72	9
退職給付に係る調整額	28	39
その他の包括利益合計	100	49
四半期包括利益	1,775	1,843
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,775	1,843

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(自己株式の消却)

当社は、2023年5月11日開催の取締役会決議に基づき、2023年5月31日付で、自己株式535,319株の消却を実施いたしました。この結果、当第1四半期連結累計期間において資本剰余金が2,098百万円、利益剰余金が674百万円、自己株式が2,772百万円減少しております。

(追加情報)

(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議いたしました。

1. 株式の分割について

(1) 分割の目的

株式の分割によって投資単位を引き下げ、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えることにより、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

(2) 分割の方法

2023年9月30日(土曜日)(当日は株主名簿管理人の休業日のため、実質的には2023年9月29日(金曜日))を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割いたします。

(3) 分割により増加する株式数(注)

分割前の発行済株式総数	4,657,300株
分割により増加する株式数	9,314,600株
分割後の発行済株式総数	13,971,900株
分割後の発行可能株式総数	30,000,000株

(注) 分割前の発行済株式総数は、2023年5月31日に実施の自己株式の消却後における株式数であり、分割により増加する株式数及び分割後の発行済株式総数は、これを基に算出しております。

(4) 分割の日程

基準日公告日	2023年9月15日(金曜日)
基準日	2023年9月30日(土曜日)
効力発生日	2023年10月1日(日曜日)

(5) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額(円)	126.40	135.34
潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益金額(円)	—	—

2. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

上記株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年10月1日(日曜日)を効力発生日として、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>1</u> 千万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>3</u> 千万株とする。

3. 資本金の額の変更について

上記株式分割による資本金の額の変更はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカ トロニクス	メカトロニク スシステム	流通機器 システム	不動産賃貸	
売上高					
外部顧客への売上高	8,545	4,265	544	465	13,821
セグメント間の内部売上高又は振替高	11	39	—	22	74
計	8,557	4,305	544	488	13,895
セグメント利益	1,349	760	6	130	2,246

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	2,246
全社費用(注)	△119
その他	△213
四半期連結損益計算書の経常利益	1,912

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカ トロニクス	メカトロニク スシステム	流通機器 システム	不動産賃貸	
売上高					
外部顧客への売上高	11,170	2,055	565	462	14,254
セグメント間の内部売上高又は振替高	10	44	—	23	77
計	11,180	2,100	565	485	14,332
セグメント利益	2,146	39	33	100	2,321

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	2,321
全社費用(注)	△199
その他	87
四半期連結損益計算書の経常利益	2,209

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。